#### No title available

Publication number: JP5346668 (A) Publication date: 1993-12-27

Inventor(s): NOZAKI KOJI; TAKECHI SATOSHI; KAIMOTO HIROKO

Applicant(s): FUJITSU LTD

Classification:

- international: G03F7/004; C07C69/54; C08F20/18; G03F7/027; G03F7/039;

H01L21/027; G03F7/004; C07C69/00; C08F20/00; G03F7/027; G03F7/039; H01L21/02; (IPC1-7): G03F7/039; G03F7/004;

G03F7/027; H01L21/027

- European:

Application number: JP19920156818 19920616 Priority number(s): JP19920156818 19920616

#### Abstract of JP 5346668 (A)

PURPOSE:To provide a radiation resist compsn. having high sensitivity and dry etching resistance by incorporating a copolymer containing 3oxocyclohexyl acrylate or methacrylate monomers as the repeating unit. CONSTITUTION:This radiation resist compsn. contains a copolymer expressed by formula having 3-oxocyclohexyl acrylate or methacrylate monomer unit, and preferably, other acrylate or methacrylate monomer unit as the repeating unit. In formula, R and R' are H or CH3 and R" is an org. acid. If this compsn. is prepared to obtain a resist material, R" is preferably an alicyclic org. group, for example, admantyl group, norbonyl group, or cyclohexyl group in order to obtain small absorption in a short wavelength region and high dry etching durability. The weight average mol.wt. of this copolymer is preferably 2000 to 3000000.

$$+ c H, - c H,$$

Also published as:

DP3236073 (B2)

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?KC=A&date=19931227&NR=534666...

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-346668

(43)公開日 平成5年(1993)12月27日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup> G 0 3 F 7/00 7/00 H 0 1 L 21/00	04 5 0 3 27 5 0 1	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
		7352-4M		21/30 301 R 審査請求 未請求 請求項の数6(全 10 頁)
(21)出願番号	特願平4-156818		(71)出願人	000005223 富士通株式会社
(22) 出願日	平成4年(1992) 6	月16日	(72)発明者	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 野崎 耕司 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
			(72)発明者	武智 敏 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
			(72)発明者	開元 裕子 神奈川県川崎市中原区 上小田中1015番地 富士通株式会社内
			(74)代理人	弁理士 青木 朗 (外2名)

(54) 【発明の名称】 レジスト組成物及びそれを用いたパターン形成方法

## (57)【要約】

【目的】 放射線感光材料に関し、高感度で且つドライ エッチング耐性が高く、露光放射線に対して透明な化学 増幅型レジスト組成物を提供する。

【構成】 本発明のレジスト組成物は、アクリル酸又は メタクリル酸3-オキソシクロヘキシル単量体単位

## 【化1】

(式中のRはH又はCH3)

を繰返し単位の一つとして含む共重合体と、酸発生剤と を含んでなる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式で表されるアクリル酸又はメ タクリル酸3-オキソシクロヘキシル単量体を繰返し単 位の一つとして含むことを特徴とする共重合体。

【化1】

## (式中のRはH又はCHa)

【請求項2】 下記一般式で表されるアクリル酸又はメ タクリル酸3-オキソシクロヘキシル単量体の繰返し単 位10~90モル%と、

【化2】

## (式中のRはH又はCHa)

下記一般式で表される他のアクリル酸又はメタクリル酸 30 とを合わせ持つ材料の開発が急務となっている。 エステル単量体の繰返し単位90~10モル%とから構 成され、

【化3】

## (式中のR′はH又はCHa、R″は有機基)

重量平均分子量が2,000~3,000,000であ ることを特徴とする、請求項1記載の共重合体。

【請求項3】 前記他のアクリル酸又はメタクリル酸エ ステルの有機基R"が脂環式有機基であることを特徴と する、請求項2記載の共重合体。

【請求頃4】 請求頃1,2 以は3 記載の共重合体と、 放射線の照射により酸を発生する化合物とを含むことを 特徴とする放射線レジスト組成物。

2

【請求項5】 請求項4記載の組成物を基板上に塗布 し、これをベークしてレジスト膜を形成し、この膜の選 択された領域のみに放射線を照射し、次いで再びベーク して、アルカリ性現像液で現像してレジストパターンを 形成することを特徴とするパターン形成方法。

【請求項6】 次の構造式を有するアクリル酸又はメタ クリル酸3-オキソシクロヘキシル。

【化4】

$$H_{z} C = C - C - C - C$$

## (式中のRはH又はCHa)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、放射線感光材料と、こ の材料を使用する微細パターンの形成方法に関する。

20 【0002】近年、半導体集積回路は高密度化が進み、 大規模集積回路(LSI)や超大規模集積回路(VLS I) が実用化されており、それにつれてこれらにおける 配線パターンの最小線幅はサブミクロンのオーダーに及 んでいる。このためには、微細パターンを実現可能な微 細加工技術を確立することが必須であり、リソグラフィ 分野では、この要求に対する解決策として露光光源の紫 外線波長をより短い波長領域へと移行させている。これ に伴い、レジスト材料についても、短波長領域での光の 吸収がより少なく、高感度と高いドライエッチング耐性

[0003]

【従来の技術】半導体装置製造の技術分野においては、 現在、化学増幅型レジストが次世代のフォトレジストと して注目されている。化学増幅型レジストの基本概念 は、光や電子線等の放射線の照射によって酸を発生する 化合物(この明細書においては以下「酸発生剤」と称す る)と、生じた酸により脱離する保護基を備え、脱保護 による化学構造の変化によって極性が大きく変わり、そ のためアルカリ水溶液に可溶性となるベースポリマーと 40 から構成される組成物である。

【0004】米国IBM社の伊藤らは、酸によりアルカ リ水溶液に可溶性となるベースポリマーとして、tーブ トキシカルボニルオキシ化されたポリ(p-ヒドロキシ スチレン)、ポリ(メタクリル酸 t - ブチル)、あるい はこれらを主要構成成分とする共重合体を提示している (米国特許第4491628号明細書)。

【0005】これらのほかに、化学増幅型レジストに適 用可能な、酸によって容易に脱離しうる保護基を持つ化 合物としては、 $\alpha$ ,  $\alpha$  – ジメチルベンジル基を保護基と 50 して導入したメタクリル酸エステルや、テトラヒドロピ

ラニル基をポリビニルフェノールの水酸基の保護基とし たもの、あるいはテトラヒドロピラニル基を保護基とし て導入したメタクリル酸エステル等が知られている。こ れらは、アセタールの酸に対する不安定さや、脱離時の ベンジルカチオンの安定性を利用したものである。

### [0006]

【発明が解決しようとする課題】半導体装置での微細パ ターン実現の要求が強まるにつれて、上述のように露光 光源が短波長に向かっているにもかかわらず、レジスト 材料は、これまでは従来使用されていたg線やi線露光 用のものをエキシマーレーザー光等の短波長光に対応で きるように改質して、例えば使用する短波長域にあるレ ジスト材料固有の吸収域をずらすことによりそのレジス ト材料を見掛け上透明にして、使用されていた。

【0007】化学増幅型レジスト材料には、透明性のほ かに、高感度であること、ドライエッチング耐性が高い こと等が要求される。しかしながら、これらの特性を程 よく兼ね備えた微細加工用の化学増幅型レジスト材料 は、いまだに実現されていない。

【0008】例えば、保護基としてt-ブチル基を有す 20 るポリマーでは、この保護基の脱離能力が低いためポリ マーの感度が低下してしまうという問題があり、また保 護基としてテトラヒドロピラニル基を有するポリマーで は、この保護基が常温で保存している間に徐々に脱離す る傾向があるため保存安定性に乏しいという問題があっ た。

【0009】更に、例えばポリ(メタクリル酸 t - ブチ ル) のようなレジスト材料は、短波長領域の光に対する 透明性は良好であるがドライエッチング耐性が不十分で スチレン) のようなレジスト材料は、逆にドライエッチ ング耐性は良好であるが、芳香族環があるので、使用し ようとする短波長光源の波長領域の光の吸収が強過ぎて 好ましくない。

【0010】本発明は、半導体装置の製造で利用される\*

\*短波長放射線の照射による微細パターンの形成に有利に 用いることができる、高感度で且つドライエッチング耐 性が高く、そして露光放射線に対して透明な化学増幅型 レジスト材料として使用することができる共重合体、及 びこの共重合体と放射線の照射により酸を発生する化合 物とを含んでなる放射線レジスト組成物を提供すること を目的とする。更に本発明は、この放射線レジスト組成 物を使用する微細パターンの形成方法を提供する。

4

#### $[0\ 0\ 1\ 1]$

【課題を解決するための手段】本発明の共重合体は、下 記一般式で表されるアクリル酸又はメタクリル酸3-オ キソシクロヘキシル単量体を繰返し単位の一つとして含 むことを特徴とする。

[0012]

【化5】

(式中、RはH又はCHs を表す。) 上記の式から明ら かなように、この繰返し単位は、酸並びにアルカリ触媒 により脱保護することのできるオキソシクロヘキシル基 を保護基として有する。

【0013】本発明の共重合体は、上記のアクリル酸又 はメタクリル酸3-オキソシクロヘキシル単量体単位以 ある一方、例えばポリ(tーブトキシカルボニルオキシ 30 外の繰返し単位として、好ましくは他のアクリル酸又は メタクリル酸エステル単量体単位を有する。この好まし い本発明の共重合体は下記一般式で表すことができる。

[0014]

[化6]

【0015】上式中のR及びR/は、独立にH又はCH 3 を表し、R" は有機基を表す。

【0016】R"の有機基は特に限定はされないが、本 発明の共重合体をKrFエキシマーレーザー(波長24 8 nm) のような短波長の遠紫外光を露光光源としてレジ スト材料として利用する場合には、このような短波長領 い有機基が好適である。とは言うものの、R″が直鎖の アルキル基の場合は、短波長領域での透明性は確保され るがドライエッチング耐性が乏しいので、R″がアルキ ル基である共重合体はレジスト材料としてはそれほど好 ましくない。

【0017】レジスト材料を目的とする場合に望ましい 域での透明性を確保するという点で、芳香族環を含まな50 R  $^{\prime\prime}$  基としては、短波長領域の光の吸収が少ないと同時

に高いドライエッチング耐性を得ることもできることから、脂環式有機基が好適である。推奨される有機基の例を非限定的に挙げれば、炭素原子数が3以上の飽和環状炭化水素基、例えば、アダマンチル基、ノルボニル基等の多環性脂環式基や、シクロヘキシル基等の単環性脂環式基といったようなものである。

【0018】上式中のmは、共重合体中のアクリル酸又はメタクリル酸3ーオキソシクロヘキシル単量体の繰返し単位(繰返し単位A)の量を10~90モル%、好ましくは30~50モル%とするような整数を表し、nは、共重合体中の他のアクリル酸又はメタクリル酸エステル単量体の繰返し単位(繰返し単位B)の量を90~10モル%、好ましくは50~70モル%とするような整数を表す。繰返し単位Aの量が10モル%未満では、この共重合体をレジスト材料として使用した場合に感度が不十分となり、90モル%を超えると相対的に繰返し単位Bの量が減少するため、所望のドライエッチング耐性が得られなくなる。反対に、繰返し単位Bの量が10モル%を下回るとドライエッチング耐性が不十分となり、90モル%を上回るとレジスト材料の感度が不足する。

【0019】本発明の共重合体の重量平均分子量は、好ましくは2,000~3,000,000である。重量平均分子量2,000未満ではガラス転移温度が50℃以下となり耐熱性に乏しく、また3,000,000を超えると粘度が高くなるため、共重合体はレジスト材料として用いるのに適さなくなる。共重合体のより好ましい重量平均分子量は5,000~1,000,000である

【0020】このように、本発明の好ましい共重合体は、アクリル酸又はメタクリル酸3ーオキソシクロヘキシル単量体の繰返し単位10~90モル%と、他のアクリル酸又はメタクリル酸エステル単量体の繰返し単位90~10モル%とから構成され、その重量平均分子量が2,000~3,000,000であることを特徴とする共重合体である。

【0021】本発明の共重合体は、アクリル酸又はメタクリル酸3ーオキソシクロヘキシル単量体と、別の適当な単量体、例えば他のアクリル酸又はメタクリル酸エステルの如きものとを、任意の通常の方法で共重合させる 40 ことによって容易に調製することができる。

【0022】本発明の共重合体の主要構成成分である、下記一般式で表されるアクリル酸又はメタクリル酸3ーオキソシクロヘキシルは、発明者らの知る限りでは、これまでに知られていない新規の化合物である。

[0023]

【化7】

$$H_{2} C = \begin{matrix} R \\ | \\ C - C - O \end{matrix}$$

(式中のRはH又はCH®を表す。)

【0024】このアクリル酸又はメタクリル酸エステル化合物は、従来のアクリル酸エステルやメタクリル酸エステルと同様に良好な重合特性を備えており、単独重合10 体はもちろんのこと、他のメタクリル酸エステルやアクリル酸エステル、あるいはスチレンなどのラジカル重合性を有する単量体との共重合体をも容易に与えることができる。更に、アクリル酸又はメタクリル酸3ーオキソシクロヘキシルの単独重合体は、他のアクリル酸エステルやメタクリル酸エステルの単独重合体とは異なる性質を持っており、興味深い。アクリル酸又はメタクリル酸3ーオキソシクロヘキシルを主要構成成分とする重合体には上記のような特性があることから、感光性材料の分野以外にも、例えば光学材料を初めとして、医薬、農薬等の分野の機能性高分子としても有用であろう。

【0025】本発明のアクリル酸又はメタクリル酸3-オキソシクロヘキシルは、任意の周知の合成方法で調製することができる。例えば、メタクリル酸3-オキソシクロヘキシルは、次に例示する四段階の方法で容易に調製することができる。

【0026】1)1、3-シクロヘキサンジオールとジ ヒドロピランとから1、3-シクロヘキサンジオールモ ノテトラヒドロピラニルエーテルを合成する。

- ある。 2)合成した 1, 3 シクロヘキサンジオールモノテト【0020】 このように、本発明の好ましい共重合体 30 ラヒドロピラニルエーテルとメタクリル酸クロリドとかは、アクリル酸又はメタクリル酸 3 オキソシクロヘキ らメタクリル酸 3 テトラヒドロピラニルオキシシクロシル単量体の繰返し単位 10 ~ 90 モル%と、他のアク ヘキシルを合成する。
  - 3) 合成したメタクリル酸3-テトラヒドロピラニルオキシシクロヘキシルから保護基のテトラヒドロピラニル基を脱離してメタクリル酸3-ヒドロキシシクロヘキシルを調製する。
  - 4) 調製したメタクリル酸3-ヒドロキシシクロヘキシルとピリジニウムジクロメートとの反応によりメタクリル酸3-オキソシクロヘキシルを得る。
  - 【0027】この四段階でメタクリル酸3-オキソシクロヘキシルを調製する方法は、後述の実施例で更に詳しく説明される。アクリル酸3-オキソシクロヘキシルの場合にも、同様の手法により容易に調製することが可能である。

【0028】本発明はまた、アクリル酸又はメタクリル酸3-オキソシクロヘキシル単量体の繰返し単位10~90モル%と、他のアクリル酸又はメタクリル酸エステル単量体の繰返し単位90~10モル%とから構成され、重量平均分子量が2,000~3,000,000 である本発明の好ましい共重合体と、放射線の照射によ

り酸を発生する化合物(酸発生剤)とを含むことを特徴 とする放射線レジスト組成物を提供する。

【0029】本発明の放射線レジスト組成物における酸 発生剤としては、通常の化学増幅型レジスト組成物で酸 発生剤として一般に使用されているいずれの化合物を使\*

\*用することも可能である。それらの酸発生剤は、次に掲 げるもので例示されるが、言うまでもなく酸発生剤はこ れらのものに限定されない。

8

【0030】・トリアリールスルホニウム塩。例えば、 【化8】

(X- はSbF6-, AsF6-, PF6-, BF4-,

【0032】・スルホネート。例えば、  $CH_3 \longrightarrow CO \longrightarrow SO_3 \longrightarrow CH_3 \longrightarrow CO \longrightarrow SO_3 \longrightarrow CO$ 

【0033】・ハロゲン化物。例えば、

【0034】本発明の放射線レジスト組成物に必要な酸 発生剤の量は、組成物を構成する共重合体及び酸発生剤 のタイプ等の条件により様々である。酸発生剤が不足し ていれば、所期の反応を十分に達成できないので不都合 50 る。更に、この繰返し単位は芳香族環を持たないため短

であり、また多過ぎるとレジスト膜に悪影響を及ぼしか ねないので好ましくない。一般的に言えば、酸発生剤の 適当な量は共重合体100重量部に対して0.1~30 重量部程度であろう。個々の組成物にとって最適な酸発 生剤量は、実験により容易に決めることができる。

【0035】本発明の組成物を用いてレジストパターン を形成するためには、基板上にレジスト組成物を塗布 し、これをベークしてレジスト膜を形成し、この膜の選 40 択された領域のみに放射線を照射し、次いで再びベーク し、そしてアルカリ性現像液で現像してレジストパター ンを形成する。

#### [0036]

【作用】本発明の共重合体を構成するアクリル酸又はメ タクリル酸3-オキソシクロヘキシルの繰返し単位は、 酸並びにアルカリ触媒により脱保護することができる3 - オキソシクロヘキシル基を保護基として有し、そのた め酸で脱保護されてカルボン酸になる。この脱保護反応 は、tープチル基が保護基である場合よりも容易に起こ

波長光の吸収がなく、透明である。共重合体の他の繰返 し単位の単量体としてドライエッチング耐性に優れたも のを用いれば、これは共重合体に十分なドライエッチン グ耐性を付与する。

【0037】本発明のレジスト組成物においては、酸発\*

\*生剤が放射線への露光により酸を発生する。生じた酸は 触媒となり、加熱によって露光部で次の反応が起こる。 [0038] 【化12】

10

カルボン酸

【0039】このレジスト組成物のベースポリマーであ る共重合体の一方の繰返し単位には、上記の反応式に示 すように酸によって容易に脱離する官能基がエステル部 に導入してあり、そしてこの反応は脱離時にプロトン酸 を再生する増幅型であるため、レジスト組成物の感度を 高くする。

【0040】露光部で生成したカルボン酸は、共重合体 像液に可溶性にし、膨潤のないパターンの形成を可能に する。

[0041]

【実施例】次に、実施例により本発明を更に説明する。 【0042】実施例1

この例では、メタクリル酸3-オキソシクロヘキシルを※

※四段階で合成する。

【0043】1)1,3-シクロヘキサンジオールモノ テトラヒドロピラニルエーテルの調製

500mlのナス型フラスコに、25g(207mmol)の 1, 3-シクロヘキサンジオール、19.18g(22 8 mmol) のジヒドロピラン、塩化メチレン80 ml、テト ラヒドロフラン80ml、260mg(1 $\mu$ mol )のピリジ の極性を変化させてこの露光部をアルカリ性水溶液の現 30 ニウム-p-トルエンスルホネートを入れ、そしてポリ テトラフルオロエチレン (PTFE) でコーティングさ れたスターラーバーを入れて、室温で20時間攪拌し、 次に掲げる式の反応を行わせた。

[0044]

【化13】

$$\begin{array}{c} O H \\ \\ O H \end{array} \qquad \begin{array}{c} O \\ \\ O H \end{array} \qquad \begin{array}{c} O \\ \\ O H \end{array}$$

【0045】次いで、ロータリーエバポレーターで減圧 下に溶媒を除去し、そして残留反応溶液を分液ロートに あけ、希炭酸水素カリウム水溶液で洗った。水層をエー テルと酢酸エチルの1:1混合溶媒で抽出し、分離した 抽出液をもとの油層と合わせて飽和食塩水で洗った。分 離後、油層溶液を無水硫酸ナトリウムで乾燥させ、そし てろ別後、溶媒を減圧下に除去して、残留物をシリカゲ 50 あった。また、この化合物の赤外分光分析の結果(KB

ルカラムクロマトグラフィーで精製し、32/68~6 4/36の酢酸エチル/ヘキサンで溶出された部分を集 めた。

【0046】粘性の高い無色透明の液体として集められ た1,3-シクロヘキサンジオールモノテトラヒドロピ ラニルエーテルの収量は10.46g(25.2%)で

r、二一ト、cm<sup>-1</sup>) は次のとおりであった。

3 4 0 1 (s), 2 9 3 8, 2 8 6 2, 1 4 5 3, 1 3 5 3, 1 1 3 4, 1 1 1 8, 1 0 7 7, 1 0 2 3 (s), 8 6 8, 8 1 2

【0047】2)メタクリル酸3-テトラヒドロピラニルオキシシクロヘキシルの調製

十分乾燥させた500mlの三つ口フラスコに、塩化カルシウム管を付けたジムロート冷却器、ラバーセプタム、窒素導入管を取付け、10.20g(50.9mmol)の1,3-シクロヘキサンジオールモノテトラヒドロピラ 10ニルエーテル、60mlの無水テトラヒドロフランを入\*

\*れ、そしてPTFEコーティングされたスターラーバーを入れて攪拌しながら、nープチルリチウム(43.7 ml、1 mmol、1.4 Mへキサン溶液)をシリンジからゆっくり滴下して、室温で1時間攪拌した。次いで、4.84g(46.3 mmol)のメタクリル酸クロリドをシリンジからゆっくり滴下した。滴下後、室温で2時間攪拌し、次に80℃で1時間攪拌して、下記の式の反応を行わせた。

12

【0048】 【化14】

$$\begin{array}{c|c}
C H_3 \\
+ H_2 C = C - C = 0 \\
C I
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C H_3 \\
C H_3 \\
C H_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C H_3 \\
C H_3
\end{array}$$

【0049】反応溶液を室温まで放冷し、100mlの水を加えて30分間激しく攪拌した。次いで溶液を500 30mlの分液ロートにあけ、油層を水層から分離後、新しい水で洗った。この洗浄後に分離した水層をジエチルエーテルで3回抽出し、分離した抽出液をもとの油層と一緒にして飽和食塩水で洗った。分離後、油層溶液を無水硫酸ナトリウムで乾燥させ、そしてろ別後、溶媒を減圧下に除去し、残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製して、4/96~16/84の酢酸エチル/ヘキサンで溶出された部分を集めた。

【0050】8.84g(64.7%)のメタクリル酸 3-テトラヒドロピラニルオキシシクロヘキシルが淡黄 40

色の液体として得られた。

【0051】3) メタクリル酸3-ヒドロキシシクロヘキシルの調製

100mlのナス型フラスコに、8.84g(32.9mm ol)のメタクリル酸3-テトラヒドロピラニルオキシシクロヘキシル、10mlのメタノール、0.5mlの2規定塩酸を入れ、そしてPTFEコーティングされたスターラーバーを入れて、50℃で攪拌し、下式の反応を行わせた。

[0052]

【化15】

$$\begin{array}{c}
C H_3 \\
H_2 C = C - C = O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C H_3 \\
O \\
O \\
O \\
H_2 C = C - C = O
\end{array}$$

【0053】2時間後、薄層クロマトグラフィーで原料が消失していることを確認して、室温まで放冷した。反応溶液を200mlの分液ロートにあけ、油層を水層から分離した。水層をジエチルエーテルで3回抽出し、抽出液をもとの油層と合わせて希炭酸水素カリウム水溶液で洗い、次いで飽和食塩水で洗った。分離後、ジエチルエーテル抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。次に、固体硫酸ナトリウムをろ別し、ろ液から溶媒を減圧下で除去し、そして残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製して、24/76~48/52の酢酸エチル/ヘキサンで溶出された部分を集めた。

【0054】得られたメタクリル酸3-ヒドロキシシク ムジクロメート(PDC)を加えて、窒素雰囲気下に登せる。 ロヘキシルの収量は5.73g(94.4%)、またそ 30 温で2時間、次いで50℃で1時間、激しく攪拌して、の赤外分光分析の結果(KBr、ニート、 $cm^{-1}$ )は次のとおりであった。 【0056】

3 4 1 5 (s), 2 9 4 3, 2 8 6 5, 1 7 1 7 (s), 1 6 3 7, 1 4 5 3, 1 3 2 6, 1 2 9 7, 1 \*

\*175 (s), 985, 816

【0055】 1) メタクリル酸 3 - オキソシクロヘキシ 20 ルの製造

十分に乾燥させた  $200 \, \mathrm{ml}$  のナス型フラスコに、  $5.7 \, 3 \, \mathrm{g} \, (31.1 \, \mathrm{mmol})$  のメタクリル酸  $3 - \mathrm{E}$  ドロキシシクロヘキシル、  $30 \, \mathrm{ml}$  の無水塩化メチレン、  $5 \, \mathrm{g}$  の  $4 \, \mathrm{A}$  モレキュラーシーブを入れ、 PTFEコーティングされたスターラーバーを入れて攪拌した。 上記のモレキュラーシーブは、 予めすりつぶして  $400 \, \mathrm{Co}$  電気炉で  $8 \, \mathrm{He}$  間加熱し、 デシケーター中で減圧乾燥させたものであった。 次に、  $35.10 \, \mathrm{g} \, (93.3 \, \mathrm{mmol})$  のピリジニウムジクロメート(PDC)を加えて、 窒素雰囲気下に室温で  $2 \, \mathrm{He}$  間、 次いで  $50 \, \mathrm{Ce}$  で  $1 \, \mathrm{He}$  間、激しく攪拌して、下式の反応を行わせた。

【0056】 【化16】

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ H_2 C = C - C = O \\ \hline \\ C \\ \hline \\ OH \\ \end{array} \xrightarrow{\begin{array}{c} PDC \\ \hline \\ \hline \\ OH \\ \end{array}} \qquad \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \\ C = C - C = O \\ \hline \\ O \\ \hline \\ OH \\ \end{array}$$

【0057】薄層クロマトグラフィーで反応終了を確認して、反応溶液を室温まで放冷し、次いでセライトを用いて減圧ろ過した。続いてセライトをジエチルエーテルで十分に洗浄し、洗浄後をろ液と一緒にして、この混合液から溶媒を減圧下に除去した。次に、残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製して、10/90~40/60の酢酸エチル/ヘキサンで溶出された部分を集めた。

【0058】得られたメタクリル酸3-オキソシクロヘキシルは無色透明の液体であり、その収量は4.61g(81.4%)であった。この化合物の赤外分光分析の結果(KBr、ニート、 $cm^{-1}$ )は次に示すとおりであった。

2957, 1718 (s), 1687 (m), 163 7, 1454, 1315, 1294, 1165 (s), 50 1086, 1021 (w), 940 (w)

この I Rデータのうち、1718cm<sup>-1</sup>のピークはエステ ルのカルボニル基に由来し、1687cm1のピークはケ トンのカルボニル基に由来し、そして1637cm<sup>-1</sup>のピ ークは共役二重結合に由来する。

【0059】また、この化合物の <sup>1</sup>H NMR (200 MHz ) 及び13 C NMR (50MHz) のスペクトルチャ ートをそれぞれ図1及び図2に示す。1H NMRデー タのうち、5. 3 3ppm のピークは3-オキソシクロへ キシルの1位のメチルプロトンに由来し、2.68、 2. 5 5 ppm の二つのダブルダブレットは2位のメチル 10 プロトンに由来する。また、13C NMRデータのう ち、208.2ppm のピークはケトンのカルボニル炭素 に由来し、166. 1ppmのピークはエステルのカルボ ニル炭素に由来する。

#### 【0060】実施例2

この例は、メタクリル酸3-オキソシクロヘキシルとメ タクリル酸アダマンチルとの共重合体の製造を説明す

【0061】50mlのナス型フラスコに、2g(11mm ol) のメタクリル酸3-オキソシクロヘキシル、1.5 2g(7.3mmol)のメタクリル酸アダマンチル、9. 2mlのジオキサン、150mg( $915\mu mol$ )のアゾビ スイソブチロニトリル (AIBN) と、PTFEコーテ ィングされたスターラーバーを入れ、窒素雰囲気下に8 0℃で6時間攪拌した。次に、この反応溶液をテトラヒ ドロフランで約30mlに希釈し、そしてこの希釈溶液を 少量のヒドロキノンを含んだ1 リットルのメタノールに 滴下して沈殿を生じさせた。沈殿物をガラスフィルター でろ別し、0. 1 mmHg及び50℃で6時間乾燥させた。 後、1リットルのメタノールを使って上記の沈殿、ろ別 及び乾燥操作を2回繰返した。最後の乾燥は、0.1mm Hg及び50℃の条件で16時間行った。

【0062】合成された共重合体の収量は2.19g (62.2%)であり、重量平均分子量は21,00 0、分散度は1.38であり、共重合体中のオキソシク ロヘキシル繰返し単位とアダマンチル繰返し単位とのモ ル比は35:65であった。また、赤外分光分析からは 次に示す結果(KRS-5、フィルム、cm<sup>-1</sup>)が得られ た。

2913, 2855, 1719, 1451, 1262, 1152 (s), 1054, 968 (m), 751 (m)

【0063】得られた共重合体の248nmにおける光の 透過度は88%(石英基板上、厚さ1 µm)であり、従 来のレジスト組成物で用いられているフェノールノボラ ック樹脂の透過度30%に比べて格段に高かった。

## 【0064】実施例3

実施例2で合成した共重合体を13重量%のシクロヘキ サノン溶液とし、この共重合体に対して10重量%のト 50 おり化学増幅型であり、現像液としてアルカリ性水溶液

16

リフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート を加えてレジスト組成物を調製した。

【0065】この組成物を、ヘキサメチルジシラザン (HMDS) 処理を施したSiO2 基板上にスピンコー トし、60℃で20分間ベークして厚さ0.6 µmの薄 膜を形成した。KrFエキシマーレーザーステッパー (NA=0.45) を使用してこの薄膜を露光後、10 0℃で60秒間ベークし、そしてテトラメチルアンモニ ウムハイドロオキシド (TMAH) の2. 38%水溶液 で現像した。

【0066】このレジスト組成物は、40mJ/cm2の露 光量で0. 4 μmのライン・アンド・スペースパターン を解像した。更に、0.95/0.05のCF4/O2 混合ガスを使って、0.3torr、300Wの条件でドラ イエッチングしたところ、ノボラック系レジストである 長瀬産業社の長瀬ポジティブレジスト820と同等のエ ッチング耐性を示した。

#### 【0067】実施例4

酸発生剤のトリフェニルスルホニウムヘキサフルオロア 20 ンチモネートの代りに、共重合体に対して20重量%の ベンゾイントシレートを用いたことを除いて、実施例3 を繰返した。

【0068】この例におけるレジスト組成物は、50mJ /cm² の露光量で0. 4 μmのライン・アンド・スペー スパターンを解像した。

### [0069]

【発明の効果】本発明の共重合体は、保護基を備えた繰 返し単位としてアクリル酸又はメタクリル酸3-オキソ シクロヘキシル単量体単位を有し、この単量体単位はレ 得られた白色の粉末を再びテトラヒドロフランに溶解 30 ジスト組成物の露光に用いられるエキシマーレーザー等 の短波長光の吸収が少なく、このような短波長光に対し て透明であり、またこの単位に導入されている保護基は t - ブチル基と比べて酸によってより容易に脱離可能で あるから、この共重合体は短波長光に対して透明にな り、且つその短波長光に対して高い感度を有するに至 る。この共重合体は更に、他の繰返し単位としてドライ エッチング耐性の高いものを使用することによって共重 合体そのもののドライエッチング耐性を高めることが可 能である。

> 【0070】従って、本発明の共重合体を有効量の適当 な酸発生剤と組み合わせて構成されたレジスト組成物 は、遠紫外光のような短波長放射線に対して透明とな り、且つそれに対する感度が高くなる。また、共重合体 の構成成分の一つとしてドライエッチング耐性の高いも のを用いることにより、遠紫外光のような短波長放射線 に対する透明性と高いドライエッチング耐性とを合わせ 持つ高感度の化学増幅型レジスト組成物を実現すること ができる。

【0071】また、本発明のレジスト組成物は上記のと

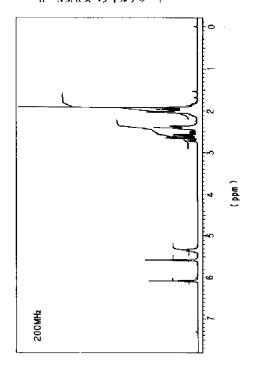
を使用するので、現像の際に膨潤することのない微細な パターンを形成することができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のメタクリル酸3-オキソシクロヘキシ

【図1】

メタクリル酸 3 -オキソシクロヘキシルの 「H NMRスペクトルチャート



18

ルの<sup>1</sup> H NMRスペクトルチャートである。【図2】本発明のメタクリル酸3ーオキソシクロヘキシルの<sup>13</sup> C NMRスペクトルチャートである。

【図2】

メタクリル酸 3 - オキソシクロヘキシルの '\*C NMRスペクトルチャート

